### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-332768

(43) Date of publication of application: 30.11.2001

(51)Int.CI.

H01L 33/00 F21V 19/00 // F21Y101:02

(21)Application number : 2000-149861

Applicant : MITSUBISHI CABLE IND LTD

(22)Date of filing:

22.05.2000

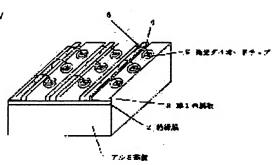
(72)Inventor: MINE HIDENORI

### (54) LIGHT EMITTING DIODE LIGHTING EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve a high heat radiation property, and at the same time to reduce

SOLUTION: Onto an aluminum substrate 1 with specific thickness, a first wide metal plate 3 and a second narrow metal plate 4 are put at specific intervals via an insulating film 2. A light emitting diode chip 5 is mounted while one electrode is connected to the first metal plate 3, and a lead 6 that is pulled out of another electrode of the light emitting diode chip 5 is connected to the second metal plate 4.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# THIS PAGE BLANK (USPTO)



## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-332768 (P2001-332768A)

(43)公開日 平成13年11月30日(2001.11.30)

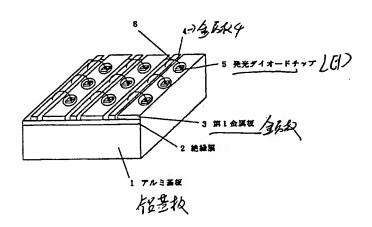
(51) Int.Cl.7		F I	デーマ:	テーマコード( <del>参考</del> )	
H01L 33/00		H01L 33/00	N 3	K013	
F21S 8/10		F21V 5/04	<b>z</b> 3	K080	
8/04		19/00	P 5	F041	
F21V 5/04		F 2 1 Y 101:02			
19/00		F21Q 1/00	N		
20,00	審查請求	未請求 請求項の数1 OL	(全 5 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特顏2000−149861(P2000−149861)	(71) 出頭人 000003263 三菱電線工業物	式会社		
(22)出顧日	平成12年5月22日(2000.5.22)	兵庫県尼崎市東	(向島西之町8	番地	
•		(72) 発明者	· ₽ / TB3采	か 二芸番館	
		工業株式会社的		AS22 46/78	
•		(74)代理人 100087804			
		弁理士 津川	友士		
		Fターム(参考) 3K013 AA0	7 BA01 EA13		
		3K080 AA1	5 BA07		
		5F041 AA3	3 DAO1 DA32 D	A33 DA34	

#### (54) 【発明の名称】 発光ダイオード照明具

### (57)【要約】

【課題】 高い放熱性を達成するとともに、コストダウ ンを達成する。

【解決手段】 所定厚みのアルミ基板1の上に絶縁膜2 を介して幅広の第1金属板3および狭幅の第2金属板4 を互いに所定間隔を隔てた状態で貼り付け、一方の電極 を第1金属板3に接続した状態で発光ダイオードチップ 5をマウントし、発光ダイオードチップ5の他方の電極 から引き出されたリード6を第2金属板4に接続してい る。



DA35 FF11

【0020】最後に、図2(f)に示すように、マウントされた発光ダイオードチップ5を覆うように光学レンズ7を設ける。

【 〇 〇 2 1 】ただし、絞り加工を省略し、また光学レンズの形成を省略することが可能である。

【0022】上記の構成の発光ダイオード照明具を採用した場合には、第1金属板3の熱容量が従来のメッキなどによる配線パターンの熱容量が大きいとともに、絶縁膜2を介して対向するアルミ基板1と第1金属板3との対向面積が大きいのであるから、絶縁膜2の熱伝導率が低くても、発光ダイオードチップ5の発熱を効果的にアルミ基板1に伝導し、著しく優れた放熱特性を実現することができる。この結果、大電流、高発熱での使用を可能とすることができる。

【0023】また、第1金属板3の厚みを大きくすることによって熱の吸収容量を高めることができ、ひいては使用条件に合わせて熱設計を変更することが可能である。

【0024】さらに、エッチング、機械加工等によって金属板から第1金属板3および第2金属板4を形成するのであるから、絶縁膜の上にメッキなどにより配線パターンを形成する場合と比較して大量生産が可能であり、コスト削減効果がある。また、エッチング、機械加工等によって金属板から第1金属板3および第2金属板4を絶縁膜2上に貼り付けるようにした場合にも、同様に大量生産が可能であり、コスト削減効果がある。

【0025】図3はこの発明の発光ダイオード照明具の製造工程の他の例を説明する図である。

【0026】図3(a)に示す金属板に対してエッチン 30 グ、機械加工等を施すことによって、第1金属板3および第2金属板4に相当する部分を形成し (図3(b)参照)、図3(c)に示すようにアルミ基板1の上に接着性の絶縁膜2を介して、第1金属板3および第2金属板4に相当する部分が形成された金属板を貼り付ける。

【0027】次いで、図3(d)に示すように、カットラインを基準として不要部分を切除するとともに、第1金属板3の発光ダイオードチップマウント予定箇所に、前方への指向性を高めるべく絞り加工を施す。

【0028】その後、図3(e)に示すように、絞り加 40 工部に発光ダイオードチップ5をマウントして一方の電 極を第1金属板3に電気的に接続し、次いでワイヤボン ディングを行って発光ダイオードチップ5の他方の電極 を第2金属板4に電気的に接続することにより電気回路 パターンを完成させる。

【0029】最後に、図3(f)に示すように、マウントされた発光ダイオードチップ5を覆うように光学レンズ7を設ける。

【0030】ただし、絞り加工を省略し、また光学レンズの形成を省略することが可能である。

【0031】この製造工程によって製造された発光ダイ 10 オード照明具は図2の製造工程により製造された発光ダ イオード照明具と同様に著しく優れた放熱特性を実現す ることができ、ひいては、大電流、高発熱での使用を可 能とすることができる。また、図2の製造工程と同様に 大量生産が可能であり、コスト削減効果がある。

【0032】図4は発光ダイオードのPNジャンクション温度(℃)-電流負荷時間(分)特性を示す図である。なお、図4中Aが従来の発光ダイオード照明具に対応し、図4中Bが図1の発光ダイオード照明具に対応している。また、電流を30mAに設定している。

20 【0033】図4から分かるように、図4中Bの方がより低い温度で飽和しており、放熱性がよいといえる。 【0034】

【発明の効果】請求項1の発明は、メッキなどにより作製された電気配線パターンより熱容量が大きい電気配線を任意に作製することができ、しかも放熱性に優れた金属基板との対向部の面積を大きくすることができ、熱放散性を向上できるという効果、金属板を絶縁膜を介して放熱性に優れた金属基板と貼り合わせて作製できるので安価に量産することができるという効果を奏する。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の発光ダイオード照明具の要部を概略 的に示す斜視図である。

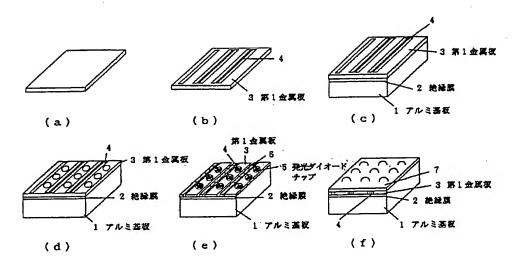
【図2】この発明の発光ダイオード照明具の製造工程の 一例を説明する図である。

【図3】この発明の発光ダイオード照明具の製造工程の 他の例を説明する図である。

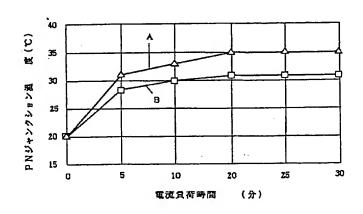
【図4】発光ダイオードのPNジャンクション温度 (℃) -電流負荷時間(分)特性を示す図である。 【符号の説明】

- 40 1 アルミ基板 2 絶縁膜
  - 3 第1金属板 5 発光ダイオードチップ

【図3】



【図4】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>
// F 2 1 Y 101:02

識別記号

FI F21S 1/02 テーマコード(参考)

G

THIS PAGE BLANK (USPTO)